



## 1 機器構成及び数量

分類	構成機器	数量
イメージジョイント3Dモジュール装置一式	セクショニングモジュール 3D解析アプリケーション 対物レンズ	1台 1式 1台

## 2 機器仕様

機器構成	項目	仕様
イメージジョイント3Dモジュール装置一式	機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セクショニングモジュール 所有している BZ-X700/710 に搭載可能であること。 蛍光撮影時に蛍光ボケの影響を受けないオプティカルセクショニング撮影が可能であること。 Zスタック画像から、ワンクリックで3D画像、断面観察が自由におこなえること。</li> <li>・3D解析アプリケーション 撮影したい範囲の端をクリック指定することで、50000×50000pixel の画像を自動で範囲設定し撮影でき、これらの撮影した画像をつなぎ目のない画像に連結すること。 撮影範囲自動設定機能付きのイメージジョイント機能を有すること。</li> <li>・対物レンズ 被写界深度が約 55 μm、視野が 7247×5456 μm のものであること。</li> </ul>

## 3 機種（以下の機種と同等以上であること）

メーカー名、製品名	型番等
キーエンス	
・セクショニングモジュール	BZ-H3XF
・3D解析アプリケーション	BZ-H3R
・対物レンズ	BZ-PA02